



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20070718000

2007 年 7 月 26 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)Renesas社製造 SSOP(8pin DCT)パッケージ Mold Compound グリーン化対応のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡申し上げます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☐ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	Renesas 社製造 SSOP(8pin DCT)パッケージ Mold Compound グリーン化対応 現行：Mold Compound グリーン化 未対応 変更後：Mold Compound グリーン化 対応	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	10 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ頂けます様、お願い申し上げます。ご不明な点、ご質問等がございましたら、営業担当或いはpcn_tij@list.ti.comまでご連絡下さいます様、お願い申し上げます。

以上

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニア・ロジック) Renesas 社(日本)製造 SSOP(8pin DCT)パッケージ製品について、モールドコンパウンドを現行部材からグリーン化に対応した部材に変更し認定しました。尚、変更後のグリーン化モールドコンパウンドは、弊社他サイトにてグリーン化部材の主要な部材として既に量産に適用しているものになります。又、評価用サンプルにつきましては、下記の製品になります。

変更内容	現行	変更後
グリーンモールドコンパウンド	未対応	対応

評価用サンプル/時期： SN74LVC3G04DCTR / 2007 年 7 月 20 日

理由：環境影響軽減及び供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
PCA9306DCTR	SN74AUC2G79DCTR	SN74LVC1G139DCTR	SN74LVC2G32DCTRE4	SN74LVC3G06DCTRE4
PCA9306DCTRE4	SN74AUC2G79DCTRE4	SN74LVC1G139DCTT	SN74LVC2G38DCTR	SN74LVC3G07DCTR
PCA9306DCTT	SN74AUC2G80DCTR	SN74LVC1G29DCTR	SN74LVC2G53DCTR	SN74LVC3G07DCTRE4
PCA9306DCTTE4	SN74AUC2G80DCTRE4	SN74LVC1G99DCTR	SN74LVC2G53DCTRE4	SN74LVC3G14DCTR
SN74AUC1G74DCTR	SN74AUC2G86DCTR	SN74LVC1G99DCTT	SN74LVC2G66DCTR	SN74LVC3G14DCTRE4
SN74AUC1G74DCTRE4	SN74AUP1G99DCTR	SN74LVC2G00DCTR	SN74LVC2G66DCTRE4	SN74LVC3G17DCTR
SN74AUC2G00DCTR	SN74AUP1G99DCTT	SN74LVC2G00DCTRE4	SN74LVC2G74DCTR	SN74LVC3G17DCTRE4
SN74AUC2G02DCTR	SN74AVC2T45DCTR	SN74LVC2G02DCTR	SN74LVC2G74DCTRE4	SN74LVC3G34DCTR
SN74AUC2G08DCTR	SN74AVC2T45DCTRE4	SN74LVC2G02DCTRE4	SN74LVC2G79DCTR	SN74LVC3G34DCTRE4
SN74AUC2G08DCTRE4	SN74AVC2T45DCTT	SN74LVC2G08DCTR	SN74LVC2G80DCTR	SN74LVC3GU04DCTR
SN74AUC2G125DCTR	SN74AVC2T45DCTTE4	SN74LVC2G08DCTRE4	SN74LVC2G86DCTR	SN74TVC3306DCTR
SN74AUC2G126DCTR	SN74AVCH2T45DCTR	SN74LVC2G125DCTR	SN74LVC2G86DCTRE4	TS5A2053DCTR
SN74AUC2G240DCTR	SN74AVCH2T45DCTT	SN74LVC2G126DCTR	SN74LVC2T45DCTR	TS5A2066DCTR
SN74AUC2G241DCTR	SN74CB3T3306DCTR	SN74LVC2G132DCTR	SN74LVC2T45DCTRE4	TS5A2066DCTRE4
SN74AUC2G32DCTR	SN74LVC1404DCTR	SN74LVC2G157DCTR	SN74LVC2T45DCTT	TXS0102DCTR
SN74AUC2G53DCTR	SN74LVC1404DCTRE4	SN74LVC2G240DCTR	SN74LVC3G04DCTR	TXS0102DCTT
SN74AUC2G53DCTRE4	SN74LVC1G123DCTR	SN74LVC2G241DCTR	SN74LVC3G04DCTRE4	
SN74AUC2G66DCTR	SN74LVC1G123DCTT	SN74LVC2G32DCTR	SN74LVC3G06DCTR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2005 年 9 月 29 日	終了	2006 年 2 月 24 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN74LVC3G04DCTR	Die Rev / Size (mils)::	D / 33 x 27	
Wafer Fab Site:	FFAB	Technology/ Fab Process: :	CMOS / ASL3C5	
Metal1-2:	TiW/AICu2%	Passivation:	10KACN	
Assembly Site:	HIT	Package/ Pin Count:	DCT / 8	
Mount Compound:	HIT EN4110	Mold Compound:	SUM EME-G600K	
Bond:	TS-0.8 Au	L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu	
MSL:	LEVEL1-260C	Flammability Rating:	UL 94 V 0	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot -A	Lot -B	Lot -C
**Steady-state Life Test	150C ,300hrs	38/0	37/0	34/0
**Temperature Humidity Bias	85/85,1000hrs	76/0	75/0	77/0
**Autoclave	121C ,96hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C,1000cys	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C,1000cys	77/0	77/0	77/0
**High Temp Storage	150C ,1000hrs	77/0	77/0	77/0
Lead Pull	Per Spec	22/0	22/0	22/0
Flammability	UL 94V-0	5/0	5/0	5/0
	UL-1694	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
X-Ray Inspection	Per Assembly Site spec	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC Level 1/260C	4/0	4/0	4/0
Manufacturability	Per Assembly Site spec	pass	pass	pass
Visual / Mechanical	Per Spec	pass	pass	pass
** Preconditioning Sequence JEDEC Level 1/260C				